

Mate2024

30th Symposium on "Microjoining and Assembly Technology in Electronics"

第30回「エレクトロニクスにおけるマイクロ接合・実装技術」シンポジウム

～エレクトロニクス産業を支える新たな価値創造～

日本のエレクトロニクス産業は、高機能化、高信頼化、小型化、低コスト化の技術開発に支えられた電子デバイス・部品を組み込んだ新たな電子システム創成によって、社会の発展を牽引してきました。さらに今後、持続可能な社会を実現していくためには、技術の科学的探求をベースとしつつ、既存の学問領域や設計・生産技術などの領域を越えて、経営・生産システムや価値システムなどの広い範囲を取り込んだオプティマイゼーションとそれに基づくシステムインテグレーションが不可欠になってきています。本シンポジウムは、エレクトロニクスにおける接合・実装技術をコアとした最新の生産技術に関して、研究者相互の情報交換の場をより広くかつ定期的に持ち、生産の科学と技術の進展を促すことを目的として企画開催されます。

日 時：2024年1月23日（火）、24日（水）

場 所：パシフィコ横浜 会議センター（横浜市西区みなとみらい1丁目1-1）

主 催：（一社）スマートプロセス学会 エレクトロニクス生産科学部会
（一社）溶接学会 マイクロ接合研究委員会

共 催：（一社）エレクトロニクス実装学会、（公社）化学工学会 エレクトロニクス部会
（一社）レーザー加工学会

協 賛：IEEE Electronics Packaging Society (EPS) Japan Chapter、応用物理学会、大阪大学大学院工学研究科テクノアリーナインキュベーション部門「つなぐ工学」、軽金属学会、精密工学会、電子情報通信学会、日本機械学会、日本金属学会、日本材料学会、日本溶接協会

早期参加申込〆切：2024年1月5日

参加申込：下記シンポジウムURLより参加登録を行って下さい。
参加費のお支払いは銀行振込にてお願い致します。

【URL】 <https://awesomenet.co.jp/mate2024/>

【振込先】 三井住友銀行 千里中央支店 普通口座 0978673
口座名：Mate組織委員会 [メイトソシキイインカイ]

【振込期限】2024年2月29日（木）

懇親会：シンポジウム1日目に懇親会を開催します。
シンポジウム参加申込時にお申し込みください。

※当日の申込みはできません。

(日 時) 2024年1月23日（火）17:40～

(場 所) パシフィコ横浜 会議センター6階
「バイブリッジカフェテリア」

(参加費) 5,000円

《参加費》※税込み、論文集PDFダウンロード付

	【早期】 2024年1月5日まで	【通常】 1月6日以降
主催団体個人会員	20,000円	22,000円
主催団体シニア会員	10,000円	12,000円
大学・国立研究機関	20,000円	22,000円
口頭発表者・座長	20,000円	22,000円
主催団体維持・賛助会員	25,000円	27,000円
共催団体会員	25,000円	27,000円
協賛団体会員	30,000円	32,000円
一般	35,000円	37,000円
学 生	10,000円	12,000円

論文集（製本版） 5,000円

* 希望者は参加申込時にお申し込みください。会期後に発送予定です。

Mate2024プログラム

1月23日(火)			
時間	A会場	B会場	C会場
8:50	開会の挨拶 Mate2024組織委員会委員長 加柴 良裕 (A会場)		
9:00 ～ 10:40	[A-1]低温ソルダリング 1. 低温接合用Sn-Bi系はんだ合金の特性と実装のトレンドについて ＊西村哲郎 ((株)日本スベア社) 2. SnBi系低温はんだ材料の開発 ＊永井智子, 森丞太郎, 岡直正, 鶴岡竜史, 北沢和哉, 吉田久彦 (千住金属工業(株)) 3. フリップチップ用低温鉛フリーはんだの機械的特性調査 ＊梅田翔太, 小林竜也, 荘司郁夫 (群馬大学), 乃万裕一, 平野寿枝, 小野関仁, 加藤禎明 ((株)レゾナック) 4. Sn-Bi-Zn-In合金の微細組織が変形挙動に及ぼす影響 ＊中脇啓貴, 巽裕章 (大阪大学), Yang Chih-han, Lin Shih-kang (国立成功大学), 西川宏 (大阪大学) 5. Sn-Ag-Cu系およびSn-Bi系ソルダーペーストのフレット形成に及ぼすセルロースナノファイバー添加の影響 ＊伊勢崎奨, 向聖良人, 会田哲夫 (富山大学), 田中裕之 (中越パルプ工業(株)), 大熊章 (松尾ハンダ(株))	[B-1]実装基板 29. 【基調講演】次世代プリント配線板・サブストレートを支える材料、プロセス技術 ＊八甫谷明彦 ((株)ダイセル) 30. RDLインターポーザの微細化と高速伝送適性 ＊高野貴正, 倉持恒, 田中雅也 (大日本印刷(株)) 31. はんだ充填用レジスタマスク膜厚のバッド密度依存性 ＊青木豊広, 中村光希, 堀部晃啓 (日本アイ・ピー・エム(株)) 32. 微小部分放電測定による放熱樹脂基板の絶縁性能評価 ＊小迫雅裕, 奥村大吾, 岡本空大, 匹田政幸 (九州工業大学)	[C-1]MEMS・医療センサ 57. 呼吸中バイオマーカーの濃縮化を目指した低温ガスセンシングシステムの検討 ＊伊藤宏文, 橋本昭二, 勝野高志((株)豊田中央研究所) 58. 液状ビレン誘導体を有する薄膜有機電界発光素子の作製 ＊岡本梨椰, 笠原崇史 (法政大学) 59. 乳酸モニタリングを旨としたモバイルイメージングシステムの開発 ＊石井健太郎, 大西佳悟, 千本拓実, 荒川貴博 (東京工科大学) 60. 超柔軟赤外イメージャーに向けた薄膜有機アクティブマトリックスの開発 ＊川端玲 (大阪大学), 李恒 (中央大学), 荒木徹平, 秋山実邦子, 杉町夏穂, 松岡望(大阪大学), 高橋典華, 酒井大揮, 松崎勇斗, 越水瞭 (中央大学), 阿部岳晃 (大阪大学), 和泉慎太郎 (神戸大学), 栗平直子, 植村隆文 (大阪大学), 河野行雄 (中央大学), 関谷毅 (大阪大学) 61. 光干渉変位センサの手術用ロボット鉗子への実装と力覚センシング ＊小牟田波丸, 森實修一, 植木賢, 武中篤, 李相錫, 松永忠雄 (鳥取大学)
10:50 ～ 12:30	[A-2]ソルダリング 6. ロジンを含むしない低残渣ペーストとその溶融挙動 ＊山本佑樹, 遠藤瑞輝, 古澤光康, 内田令芳 ((株)弘輝) 7. 赤外線画像を活用したフローはんだ付けにおける工程内不良抑制システムの開発 ＊濱田若輝, 川添徹也, 山下浩儀, 北川惣康(三菱電機(株)) 8. Sn-Sb-Ag-Ni-Ge系はんだ合金の疲労特性およびミクロ組織に与えるAg添加量の影響 ＊川井健太郎, 小林竜也, 荘司郁夫(群馬大学), 三ツ井恒平, 渡邊裕彦 (富士電機(株)) 9. 青色半導体レーザを用いた純銅リボンはんだ付中の温度分布と微細組織の評価 ＊貴田優希, 巽裕章, 竹中啓輔, 佐藤雄二, 塚本雅裕, 西川宏 (大阪大学) 10. ロボットソルダリングにおける動作パラメータの視覚情報を用いた自動設定 ＊今田秀憲, 松嶋道也 (大阪大学), 寺岡巧智, 中村健太, 見島雄太, 萬田哲史, 海老名将弥 (白光(株)), 藤本公三, 福本信次 (大阪大学)	[B-2]次世代デバイス・パッケージ 33. チップレットで構成されたマイクロプロセッサの温度予測に関する研究 ＊西剛何 (足利大学) 34. 狭ピッチバンプを有する半導体パッケージのフリップチップ実装 ＊真田昌樹, 今藤桂, 清水規良 (新光電気工業(株)) 35. ダイレベルハイブリッド接合における接合強度評価 ＊吉原佑樹, 布施淳也, 岩田知也, 佐野麻理恵, 井上史大 (横浜国立大学) 36. ピラースペンディッドブリッジ(PSB)チップレット集積技術のための高生産性/狭ピッチ接続技術 ＊河野一郎, 黒羽淳史, 湯浅正敏, 米谷佳浩 (アオイ電子(株)), 栗田洋一郎 (東京工業大学) 37. 負荷方向の違いによる有機薄膜トランジスタの電気特性変動における接触抵抗の影響 ＊井上將太郎, 小金丸正明 (鹿児島大学), 三成剛生, 北口絵理 ((国研)物質・材料研究機構), 池田徹 (鹿児島大学)	[C-2]システム化・解析・シミュレーション 62. 【基調講演】トポロジ―最適化:現在と将来 ＊泉井一浩 (京都大学) 63. 逐次近似最適化における学習データ数削減に関する研究 ＊高尾知樹, 岩田剛治, 若松栄史 (大阪大学) 64. DV-Xα分子軌道法によるNb基B1型及びA15型超伝導化合物の化学結合性評価 -超伝導体-半導体ヘテロ構造の構成元素としてのNbの可能性- ＊高原渉 (大阪大学) 65. モーターコイル製造のための銅線の動的挙動解析 ＊廣澤太一, 若松栄史, 岩田剛治 (大阪大学), 鈴木寛典, 坂上篤史 (三菱電機(株))
12:30	昼食休憩・展示 & Coffee Break(13:00~13:30)		
13:30 ～ 15:30	プレナリーセッション：エレクトロニクス産業を支える新たな価値創造 ～次世代につながるテクノロジー～ 1. ダイヤモンド電界効果トランジスタの社会実装に向けて 川原田 洋 (早稲田大学) 2. Intel Packaging Technologies 富田 至洋 (インテル(株))		
15:40 ～ 17:20	ポスターセッション：ショートプレゼン 15:40~16:15(A会場)、パネル説明 16:20~17:20、展示 & Coffee Break(3階 フォワイエ) P-1. パワー半導体向け焼結材料の機械的特性評価方法の開発 ＊林 和 (群馬県立群馬産業技術センター), 荘司郁夫, 小林竜也 (群馬大学), 三ツ木寛尚 (群馬県立群馬産業技術センター) P-2. AgSn液相拡散接合シートの開発 ＊岸本貴臣, 竹内順一 (田中貴金属工業(株)) P-3. Alワイヤの超音波接合においてNiめっきが微細組織に及ぼす影響 ＊小野寺一真, 岩本知広 (茨城大学), 濱田賢祐 (超音波工業(株)) P-4. 深層学習を利用したはんだポイド率及びはんだ被覆範囲の自動測定手法の開発 ＊植木竜佑, 長谷川将司, 高橋政典 ((株)クオルテック) P-5. Sn-Bi合金のひずみ速度感受性指数測定 ＊岡山千紘, 黒瀬雅詞, 山内啓 (群馬工業高等専門学校) P-6. 毛細管圧力を駆動力とした液相浸透ダイアタッチ技術 ＊尾関慎太郎, 宮島領, 松嶋道也, 福本信次 (大阪大学) P-7. 水酸化ナトリウムとギ酸を用いた金属塩生成接合法によるA5052の環境調和型真空固相接合＊滝瀬陽斗, 小山真司 (群馬大学), 奥脇三男, 長濱拓也, 北森龍之介(金属技研(株)) P-8. ギ酸塩被膜処理を施したCu板とSn-Znはんだの接合性評価 ＊山崎浩次, 井上岳斗, 小山真司 (群馬大学) P-9. テトラセン誘導体を用いた緑色電気化学発光素子の特性評価 ＊羽田祥真, 笠原崇史 (法政大学) P-10. Sn ²⁺ を還元剤としたCu-Sn合金メソ粒子の合成 ＊早川大翔, 武田翼, 松永泰治, 荒木駿佑 (室蘭工業大学), 西川宏 (大阪大学), 安藤哲也, 葛谷俊博 (室蘭工業大学) P-11. 摩擦攪拌接合したA2024アルミニウム合金の時効特性 ＊遠藤柊将, 安藤哲也(室蘭工業大学), 小野寺邦之((株)ワールド山内), 櫻庭洋平((地独)北海道立総合研究機構) P-12. 金属材とCFRTP間のガルバニック腐食を抑制する特殊めっき膜の特性評価 ＊清水颯, 荘司郁夫, 小林竜也 (群馬大学) P-13. 異形銀フィラー含有導電性ペーストと銅電極間の界面抵抗 ＊堂前天良, 田中智也(大阪大学), 古井裕彦, 藤田晶, 鎌田信雄(化研テック(株)), 松嶋道也, 福本信次(大阪大学) P-14. 無電解ニッケル-リンめっき層と電析銅の密着性に及ぼすリン含有量の影響 ＊小池悠文, 松嶋道也, 福本信次 (大阪大学)		
17:40	懇親会 (6階 バイブリッジカフェテリア)		

1月24日(水)			
時間	A会場	B会場	C会場
9:00 ～ 10:40	[A-3]Cu焼結接合 11. 【基調講演】結晶制御・分散制御を利用した低温焼結可能な銅接合材料系 ＊米澤徹 (北海道大学) 12. 高分散性銅粒子を含む銅接合材で形成した緻密な接合層の熱安定性 ＊江山善昭, 稲家修一, 鈴木佑京, 福田泰紀, 武居正史 (花王(株)) 13. 加圧焼成型銅ペーストの接合プロセスの検討 ＊川戸祐一, 濱西恭良, 有村英俊 (石原ケミカル(株)) 14. 大小銅粒子混合と酸化制御による放熱接合材の低温焼結性向上 ＊阿曾崇志, 西尾正樹, 塚本宏樹, 米澤徹 (北海道大学)	[B-3]導電性接着剤 38. 導電性フィラーを添加したエポキシモノリスの電子デバイスへの応用 ＊加茂芳幸 (三菱電機(株)), 松本章一 (大阪公立大学) 39. フェノール系樹脂バインダを用いた銅系導電性ペーストの電気的信頼性に及ぼすフィラー酸化の効果 ＊松浪由香里, 小田島大輔, 井上雅博 (群馬大学) 40. 酸無水物硬化系導電性接着剤の銀フィラー焼結と金属電極に対する界面電気抵抗の変化 ＊福島孝典, 井上雅博 (群馬大学) 41. 高温高湿環境曝露中の銅系導電性ペースト/電極間の電気的接続信頼性評価 ＊小田島大輔, 松浪由香里, 井上雅博 (群馬大学) 42. 導電性接着剤におけるSn-3.0Ag-0.5Cu架橋による伝導性の向上 ＊谷山耕太郎, 千田拓実, 松嶋道也, 福本信次 (大阪大学)	[C-3]接合信頼性(1) 66. Sn-AuおよびSn-In希薄合金の高温変形挙動と熱疲労特性 ＊濱田真行 ((地独)大阪産業技術研究所) 67. はんだ中への電極溶解を抑制可能なMoバリア電極の耐衝撃性 ＊前田和孝, 豊田大介, 三澤卓(京セラ(株)) 68. 等2軸応力を受けるダイアタッチ接合部の熱疲労破壊進行過程シミュレーション ＊船寺早紀, 苅谷義治 (芝浦工業大学) 69. 接合界面端の応力特異性を用いた微小接着継手の強度予測 ＊木村光貴, 苅谷義治 (芝浦工業大学) 70. 高信頼性ハンダ合金の開発及び接合信頼性リスクに対する総括 ＊横山貴大, 吉川俊策, 飯島裕貴, 出井寛大(千住金属工業(株))
10:50 ～ 12:30	[A-4]Ag焼結接合 15. Ag焼結接合の乾燥工程における溶剤揮発の均一化 ＊謝崇亮, 村松佑哉, 別芝範之 (三菱電機(株)) 16. AgペーストQ01CとNi, Al基板との接合特性及び影響因子 ＊酒金亭, 立花芳恵, 堀江竜貴 (千住金属工業(株)) 17. 通電による組織制御を活用したSiC/Ag焼結接合の高信頼化 ＊松田哲夫, 松田朋己, 神原淳 (大阪大学) 18. Ag-カルボン酸間の反応を利用したAg/Si直接接合 ＊岡本拓也, 松田朋己, 神原淳 (大阪大学) 19. Ag焼結接合における多層無電解Agメッキの耐熱性 ＊下山章夫, 上島稔 ((株)ダイセル), 大久保洋樹 (上村工業(株))	[B-4]プリンタブル・エレクトロニクス 43. ハンセンパラメータを用いた基板表面の化学的性状の定量評価 ＊井上雅博, 猪野塚峻 (群馬大学) 44. インモールド・エレクトロニクスの高精密化に向けた真空成形中の配線電気抵抗制御の検討 ＊大嶋玲奈, 井上雅博 (群馬大学) 45. 部品実装したストレッチャブル印刷回路の一括真空成形による3次元デバイスの試作 ＊井上雅博, 福島孝典, 大嶋玲奈 (群馬大学) 46. マイクロトランスファープリンティングによる異種光機能材料集積 ＊鎌谷淳一, 古田寛和, 中村将, 岡本慎也, 久田和也 (パナソニック・デバイス(株)), Maximilien BILLET, Stijn CUYVERS, Artur HERMANS, Gunther ROELKENS, Bart KUYKEN (Ghent University-imec), Sandeep Seema SASEENDRAN, Philippe SOUSSAN, Xavier ROTTENBERG, Jon Ø. KJELLMAN (imec) 47. プリントドエレクトロニクス用電極とSn-57.6Bi-0.4Ag低融点はんだの界面反応 ＊小山真里奈, 小林竜也, 荘司郁夫 (群馬大学), 坂井修大, 藤井香織, 佐々木柊之 (サカタインクス(株))	[C-4]接合信頼性(2) 71. 車載電子部品におけるはんだ接合部の高信頼化検討 ＊加藤薫子, 池田靖 ((株)日立製作所), 山下志郎 (日立Astemo(株)) 72. 深層学習を利用したBGAにおけるはんだクラック進展三次元解析 ＊長谷川将司, 鬼塚梨里, 緒方森, 植木竜佑, 高橋政典 ((株)クオルテック) 73. 線膨張係数の異なる基板材料におけるはんだクラック三次元解析 ＊鬼塚梨里, 長谷川将司, 植木竜佑, 緒方森, 高橋政典 ((株)クオルテック) 74. Ag粒子焼結体の疲労き裂進展速度におよぼす微細構造効果 ＊齋田和哉, 苅谷義治 (芝浦工業大学), 佐々木幸司 (ナミック(株)) 75. 高密度実装向けAu粒子接合技術の開発 ＊井上謙一, 牧田勇一, 藤野昌仁, 小柏俊典 (田中貴金属工業(株))
12:30	昼食休憩・展示 & Coffee Break(13:00~13:30)		
13:30 ～ 15:10	[A-5]パワーデバイス(1) 20. パワーモジュール内部における封止樹脂-金属基板接合部の疲労き裂進展挙動の究明 ＊中川終, 石井英敏, 池田徹, 小金丸正明 (鹿児島大学), 加々良剛志 (住友ベークライト(株)) 21. リードフレーム粗化処理による樹脂密着性およびパワーサイクル耐量向上 ＊渡壁翼, 中村瑠子, 岩谷昭彦, 齊藤まい, 浅井竜彦, 郷原広道 (富士電機(株)) 22. アルミニウム粒子を用いた次世代パワー半導体実装用接合材の創製 ＊後藤梨花, 荘司郁夫, 小林竜也 (群馬大学) 23. パワーモジュール接合部破損への熱弾塑性クリープ現象を考慮した非線形破壊力学パラメータの適用 ＊秋永友樹 (佐賀大学), 犬戸信之 (近畿大学), 葉山裕, 萩原世也, 武富神也 (佐賀大学), 小金丸正明 (鹿児島大学), 宮崎剛幸 (京都大学) 24. パワーモジュールの絶縁に用いられるエポキシ樹脂中の塩化ナトリウム不純物が空間電荷蓄積特性に及ぼす影響の評価 ＊佐藤孔亮, 進藤敦樹, 三宅弘晃, 田中康寛 (東京都市大学)	[B-5]マイクロ加工・接合(1) 48. レーザ誘起還元法を用いたナノ粒子合成の高効率化 ＊中村貴宏, 黒田陸斗, 柴田秀平 ((株)illumius) 49. モールド樹脂バリ取り工程が及ぼすパッケージへの影響 ＊堀山力, 河原史倫, 小杉祥, 西原孝太郎, 鹿野武敏 (三菱電機(株)) 50. RF向けガラス配線基板と個片化技術の開発 ＊澤田将士, 小林西, 梅村優樹, 高田健央, 中村司 (TOPPANホールディングス(株)) 51. 化合物半導体の結晶へき開型切断加工 ＊北市亮, 浅井義之, 武田真和, 福西利夫 (三星ダイヤモンド工業(株)) 52. レーザを用いた高放熱基板への新規コンボジット銀ナノ粒子電極材料の作成及び評価 ＊大江舞, 草野浩幸, 川本康和, 北崇 ((株)フェクト), 鈴木好明 ((地独)鳥取県産業技術センター)	[C-5]有機/無機接合 76. 溶融亜鉛めっき鋼板へのプラズマSi表面処理によるシリコン接着剤の高接着化 ＊露木康博 ((株)日立製作所), 新山晃右 (日立Astemo(株)), 春名博史 ((株)日立製作所), 石井利昭, 執行俊和 (日立Astemo(株)) 77. 高温高湿環境下における鋼/Al合金接着継手強度に及ぼすアミノ基含有シラン系処理の影響 ＊片山太郎, 小坂豪志, 小林竜也, 荘司郁夫 (群馬大学) 78. 導電性接着剤中のセルロースナノファイバーの銀析出を利用した可視化 ＊北本菜々花, 松嶋道也, 福本信次 (大阪大学) 79. ビスフェノールF型エポキシ樹脂/Al接着界面の劣化挙動に及ぼす高温高湿時効の影響 ＊渡部樹, 小林竜也, 荘司郁夫 (群馬大学) 80. 半導体パッケージの金属/樹脂界面における剥離評価手法の研究 ＊松尾圭一郎, 久保悠, 山本哲也 ((株)東芝), 田藤京 (東芝デバイス&ストレージ(株)), 池田徹 (鹿児島大学)
15:10	展示 & Coffee Break		
15:30 ～ 16:50	[A-6]パワーデバイス(2) 25. 応力測定TEGチップを用いたはんだ付け時のチップに生じる熱応力の測定 ＊勅使河原一成, 藪垣良美, 鈴木裕一郎, 中島泰 (三菱電機(株)) 26. 超小型パワーチップサイズPKGとモジュール化の研究 ＊高橋弘樹, 鈴木慧太, 喜多村明, 遠藤哲郎, 高橋良和 (東北大学) 27. ロータス型ボラス銅・はんだ複合構造を活用した高放熱モジュールの試作評価 ＊巽裕章 (大阪大学), 磯野浩 (シーマ電子(株)), 平瀬加奈 (大阪大学), 井手拓哉 ((株)ロータス・サーマル・ソリューション), 西川宏 (大阪大学) 28. 高温・高電界下で25μmのポリイミド系樹脂フィルム内に蓄積する空間電荷分布の観測 ＊小林亮太, 小川弘晃, 佐藤孔亮, 三宅弘晃, 田中康寛 (東京都市大学)	[B-6]マイクロ加工・接合(2) 53. 多層層極接合 ＊高橋誠 (大阪大学) 54. H₂OインサートによるADC12アルミニウム合金の低電力抵抗溶接 ＊石川快, 小山真司 (群馬大学), 小田敏弘, 加藤豪 (ジャココ(株)) 55. Al含有フェライト系ステンレス鋼のCu-Mn-Niろうによるろう付 ＊塚越皓也, 小林竜也, 荘司郁夫 (群馬大学), 広橋順一郎, 井上勝文, 和氣庸人 ((有)和氣製作所), 山本巨紀 ((株)カンドリ工業) 56. 青色レーザを用いたリードフレームと銅基板の非接触はんだ接合に関する基礎的検討 ＊佐藤慶吾, 茅原崇 (古河電気工業(株)), 大熊章(松尾ハンダ(株))	[C-6]めっき 81. TEMPO酸化CNFを複合材とした無電解Niめっき膜の成膜および特性調査 ＊川鍋渉, 飯岡諒, 小林竜也, 荘司郁夫 (群馬大学) 82. PRパルス電解を用いた粒状銅めっき皮膜の形成と密着性 ＊中亮太, 吉川純二 (奥野製薬工業(株)), 石原隆雄, 大野厚三 (日電精密工業(株)) 83. エポキシ樹脂との接着性向上に向けた三次元めっき膜生成条件の影響評価 ＊PHAM THAIANH, 荘司郁夫, 小林竜也 (群馬大学) 84. 複合めっき法によるAl粒子含有Znめっきの創製と評価 ＊安彦祐輝, 荘司郁夫, 小林竜也 (群馬大学)
16:50 ～17:10	表彰式 (A会場) 閉会の挨拶 Mate2024実行委員会委員長 作山 誠樹 (A会場)		

組織委員会

委員長：加柴良裕 (大阪大学)

副委員長：青柳昌宏 (熊本大学)

福本信次 (大阪大学)

委員：秋山靖裕 ((株)東芝)	瀧美幸一郎 (MTイノベーション)	岩本知広 (茨城大学)
大熊秀雄 ((有)エイチ・ティー・オー)	小勝俊巨 (日本電気(株))	折井靖光 (Rapidus(株))
戒能修三 (パナソニックホールディングス(株))	久保雅男 (パナソニック(株))	小林紘二郎 ((一財)電子科学研究所)
齋藤重正 ((株)テー・シー・富山)	嶋田勇三 ((一社)日本実装技術振興協会)	菅沼克昭 (大阪大学)
高橋康夫 (大阪大学)	高橋良和 (東北大学)	武井利泰 ((株)ジャパンユニックス)
竹本 正 (大阪大学)	田中敏宏 (大阪大学)	貫井 孝 (京都大学)
廣瀬明夫 (大阪大学)	藤原伸一 ((株)日立ハイテック)	松村慶一 (インフィテックエム(株))
南二三吉 (大阪大学)	村井淳一 (三菱電機(株))	山本治彦 (FICT(株))
吉田 隆 (富士電機(株))		

実行委員会

委員長：作山誠樹 (Rapidus(株))

副委員長：荘司郁夫 (群馬大学)

西川 宏 (大阪大学)

委員：青木豊広 (日本アイ・ピー・エム(株))	青木雄一 (エスベック(株))	赤松俊也 (富士通(株))
朝倉義裕 (神戸市立工業高等専門学校)	新井 進 (信州大学)	安藤哲也 (室蘭工業大学)
池田 徹 (鹿児島大学)	石橋正朗 (TOPPANホールディングス(株))	出田吾朗 (三菱電機(株))
井出英一 ((株)日立製作所)	井上雅博 (群馬大学)	今井健太郎 (群馬大学)
岩田剛治 (大阪大学)	上島 稔 ((株)ダイセル)	上西啓介 (大阪大学)
榎本貴男 (Rapidus(株))	海老原伸明 (NECスペーステクノロジー(株))	岡本康寛 (岡山大学)
小椋 智 (大阪大学)	加藤禎明 ((株)レゾナック)	鎌田信雄 (化研テック(株))
上川路優 (化研テック(株))	木村文信 (東京大学)	葛谷俊博 (室蘭工業大学)
小林竜也 (群馬大学)	小山真司 (群馬大学)	阪元智朗 (オムロン(株))
佐藤 弘 ((国研)産業技術総合研究所)	佐名川佳治 (パナソニック(株))	真田昌樹 (新光電気工業(株))
杉澤義信 ((株)タムラ製作所)	関本隆司 (日本アビオニクス(株))	瀬知啓久 (東京プレイズ(株))
高尾尚史 ((株)豊田中央研究所)	高岡英清 ((株)村田製作所)	高木和順 (千住金属工業(株))
高橋邦夫 (東京工業大学)	巽 裕章 (大阪大学)	寺岡巧知 (白光(株))
富岡泰造 ((株)東芝)	濱田真行 ((地独)大阪産業技術研究所)	久田隆史 (Rapidus(株))
平井維彦 (日立Astemo(株))	藤野純司 (三菱電機(株))	前田和孝 (京セラ(株))
松坂壮太 (千葉大学)	松嶋道也 (大阪大学)	松林 良 (パナソニックインダストリー(株))
圓尾弘樹 (パナソニックコネクタ(株))	見山克己 (北海道科学大学)	森 三樹 (華為技術日本(株))
森 貴裕 ((株)ADEKA)	両角 朗 (富士電機(株))	山内 啓 (群馬工業高等専門学校)
山口敦史 (パナソニックインダストリー(株))	山中公博 (中京大学)	山根常幸 ((株)東レリサーチセンター)
山部光治 ((株)東芝)	山本哲也 ((株)東芝)	山本佑樹 ((株)弘輝)
横沢伊裕 (UBE(株))	若松栄史 (大阪大学)	渡邊 聡 (藤倉化成(株))
渡辺 潤 (OKIネクステック(株))	渡邊裕彦 (富士電機(株))	

会場アクセス

パシフィコ横浜 会議センター

- * みなとみらい線 みなとみらい駅より徒歩3分
- * JR線・市営地下鉄 桜木町駅より徒歩12分
- * 横浜駅よりタクシー7分、シーバス(船)で10分



問い合わせ先：Mate 2024 事務局

(TEL) 0725-90-6512 (FAX) 0725-90-6513

(E-mail) mate@awesomenet.co.jp (URL) <https://awesomenet.co.jp/mate2024/>